

請求の範囲

- [請求項1] シリコンウェーハ研磨用組成物であって、
砥粒と、セルロース誘導体と、界面活性剤と、塩基性化合物と、水とを含み、
前記セルロース誘導体の重量平均分子量は 1.2×10^4 よりも大きく、
前記界面活性剤の分子量は 4,000 未満である、研磨用組成物。
- [請求項2] 前記界面活性剤として、ノニオン性界面活性剤を含む、請求項1に記載の研磨用組成物。
- [請求項3] 前記界面活性剤として、ポリオキシアルキレン構造を有する界面活性剤を含む、請求項2に記載の研磨用組成物。
- [請求項4] pHが8.0以上12.0以下である、請求項1から3のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項5] 前記界面活性剤の含有量は、前記砥粒100重量部に対して0.005重量部以上15重量部以下である、請求項1から4のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項6] 前記セルロース誘導体の含有量は、前記砥粒100重量部に対して0.1重量部以上20重量部以下である、請求項1から5のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項7] 前記砥粒はシリカ粒子である、請求項1から6のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項8] 前記シリカ粒子の平均一次粒子径は5nm以上100nm以下である、請求項7に記載の研磨用組成物。
- [請求項9] シリコンウェーハの仕上げ研磨に用いられる、請求項1から8のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項10] 予備研磨工程と、仕上げ研磨工程と、を含み、該仕上げ研磨工程において研磨用組成物を用いて研磨対象基板を研磨する、シリコンウェーハの研磨方法であって、

前記研磨用組成物として、

砥粒と、セルロース誘導体と、界面活性剤と、塩基性化合物と、水とを含み、前記セルロース誘導体の重量平均分子量が 1.20×10^4 よりも大きく、前記界面活性剤の分子量が4,000未満である研磨用組成物を用いる、研磨方法。